



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 新 川
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 長 野 高 志
(コード番号 6274 東証第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 常 務 執 行 役 員
経 営 管 理 本 部 長 森 琢 也
(電話番号 042-560-4848)

中期経営計画策定に関するお知らせ

当社は、平成 33 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画「Challenge Shinkawa 2020」を策定しましたので、以下にお知らせいたします。

記

1. 中期経営計画「Challenge Shinkawa 2020」

当社グループは、微細化・高精度化・低コスト化が進む半導体パッケージに対応するため、コスト競争力や高付加価値を伴う製品の拡販、大手OSATなどの新規顧客の開拓、タイ工場への生産移管などの収益構造改革に注力してきました。これらは着実に進展し、平成29年3月期には、8期連続赤字からの脱却を果たすことができました。

近年、PCやスマートフォンに留まらず、家電製品や自動車、工場の設備など、様々なモノがインターネットに接続し始めており、IoT (Internet of Things : モノのインターネット) 社会が実現しつつあります。IoT分野が半導体市場の新たな牽引役として期待されるなか、当社グループは、半導体市場の新時代到来を見据え、平成33年3月期 (2020年度) を最終年度とする中期経営計画「Challenge Shinkawa 2020」を策定しました。ボンディング技術のリーディングカンパニーを目指し、常に実装技術の革新に挑戦することで、持続的成長を図ります。

2. 基本戦略

①既存事業の成長

IoT時代の到来を受け、半導体パッケージへの要求には様々な変化が見られます。データストレージのSSD化やメモリの高速化に対応すべく、引き続きワイヤボンダ、ダイボンダの機能強化を進めるとともに、メモリキューブや先端CPUに使われる3次元/2.5次元実装に向け、Thermal Compression Bondingなどの最先端実装工法に対応したフリップチップボンダの開発および拡販を推進します。

また、スマートフォンなどの通信機器の高機能化にともない、PoP (Package on Package) やFO-WLP (Fan Out- Wafer Level Package) などの高機能パッケージの需要が拡大しつつあり、これらに対応したフリップチップボンダの機能強化も進めています。

②新しいビジネス価値の開発

Shinkawa Smart Bonding Solutionのコンセプトのもと、半導体組立工程にIoT機能を取り込んだソリューションの開発を進めています。装置のインテリジェント化 (センシング機能の強化)、ネットワークのインテリジェント化 (データ収集・解析機能の強化)、プロセスのインテリジェント化 (ノウハウのソフト化) を推進し、IoT社会の進展に伴って発生する課題に先んじてソリューションを提案することで、顧客満足と企業価値の向上を図ります。

③組織活性化と人材育成

創造性を発揮する組織へと変革するため、多様な人材の確保が必要となります。世界各国の優秀な人材が活躍するステージを提供するとともに、意識改革をはじめとした人材育成に注力しています。

3. 連結業績目標

(百万円)

	平成30年3月期 (予想)	平成33年3月期
売上高	19,500	30,000
営業利益	280	3,000
経常利益	320	3,000
当期純利益	200	2,300

※最終年度ROE (自己資本純利益率) は、10%レベルを目標とします。

以 上


中期経営計画

「Challenge Shinkawa 2020」

2017年5月12日



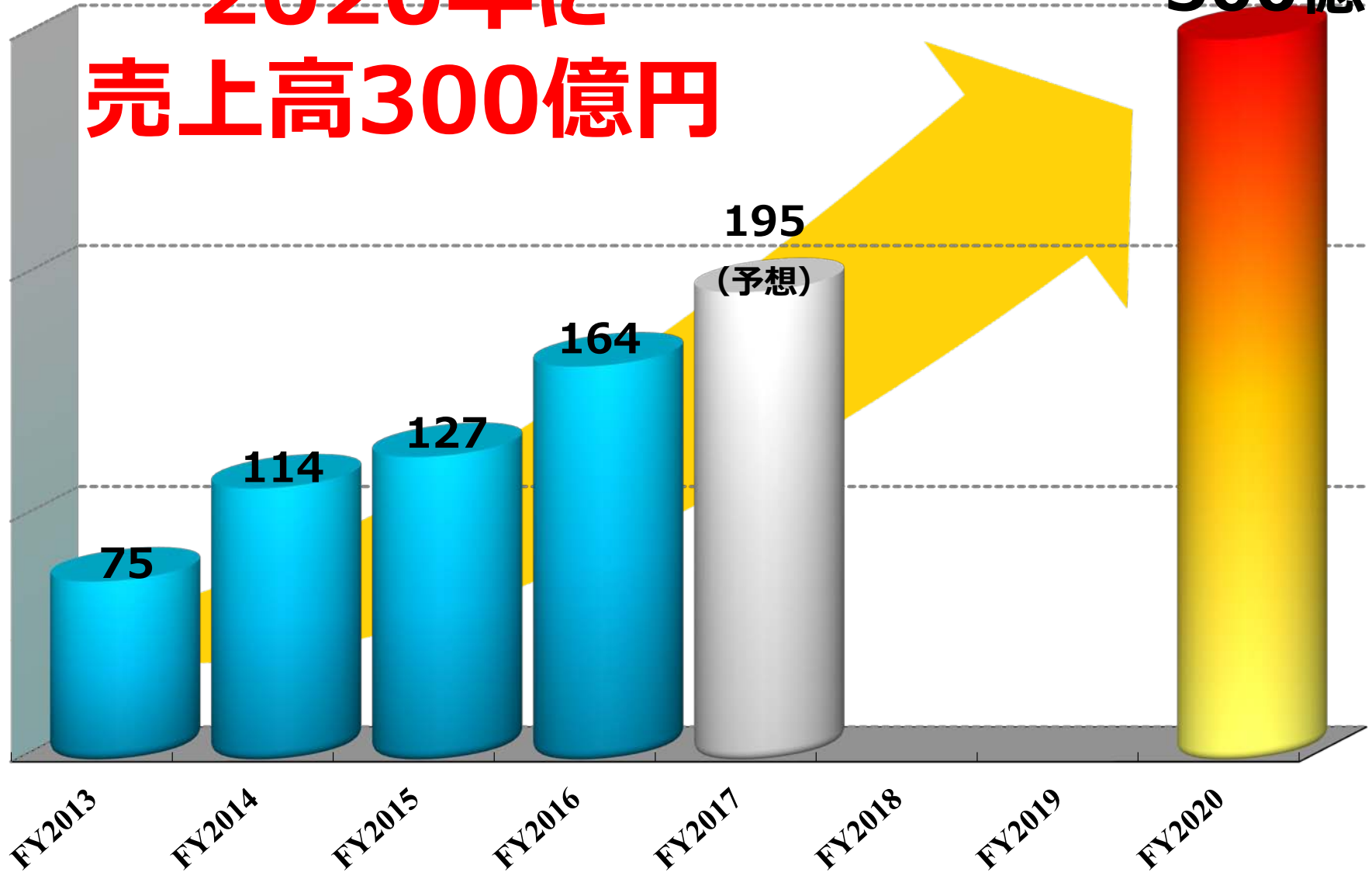
Challenge Shinkawa 2020

 新川は、ボンディング技術の
リーディングカンパニーを目指し、
常に実装技術の革新に挑戦します

Shinkawa Challenge Shinkawa 2020

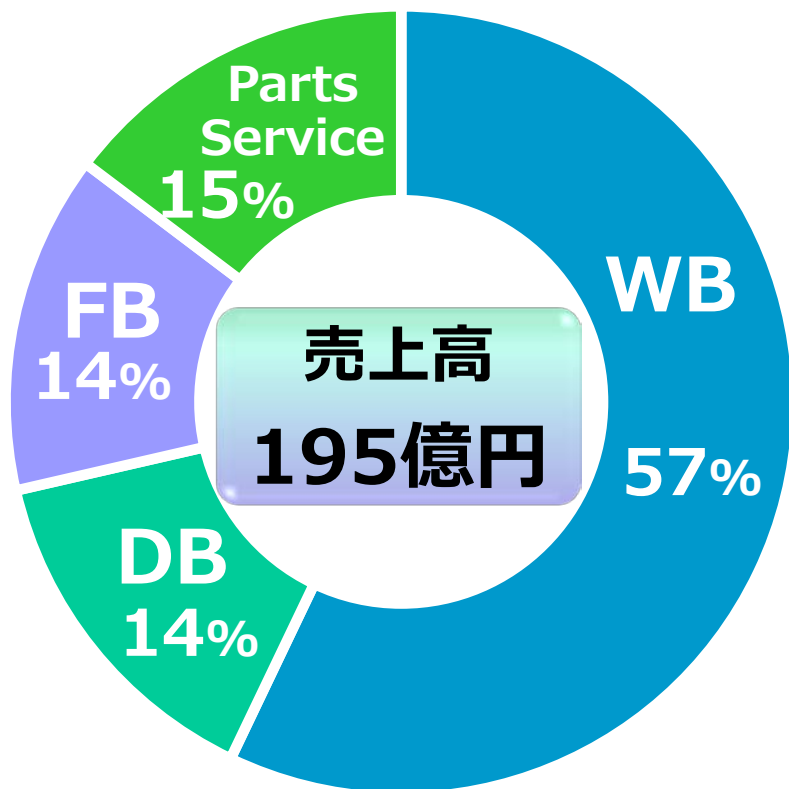
2020年に
売上高300億円

300億



Shinkawa Challenge Shinkawa 2020

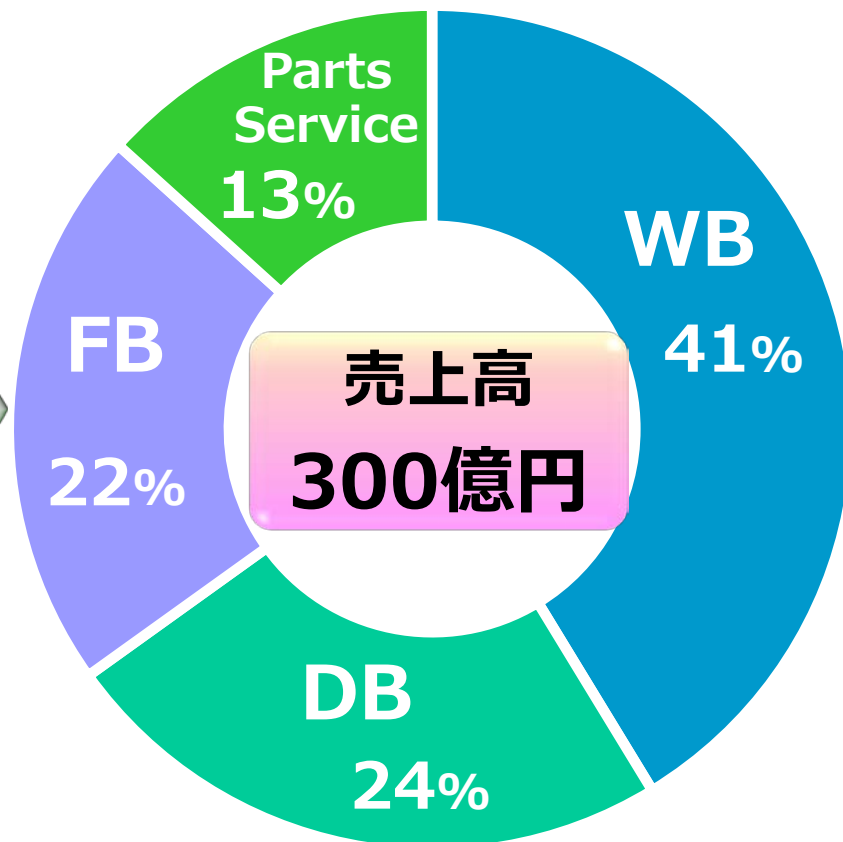
FY2017



売上高
195億円

営業利益
2.8億円

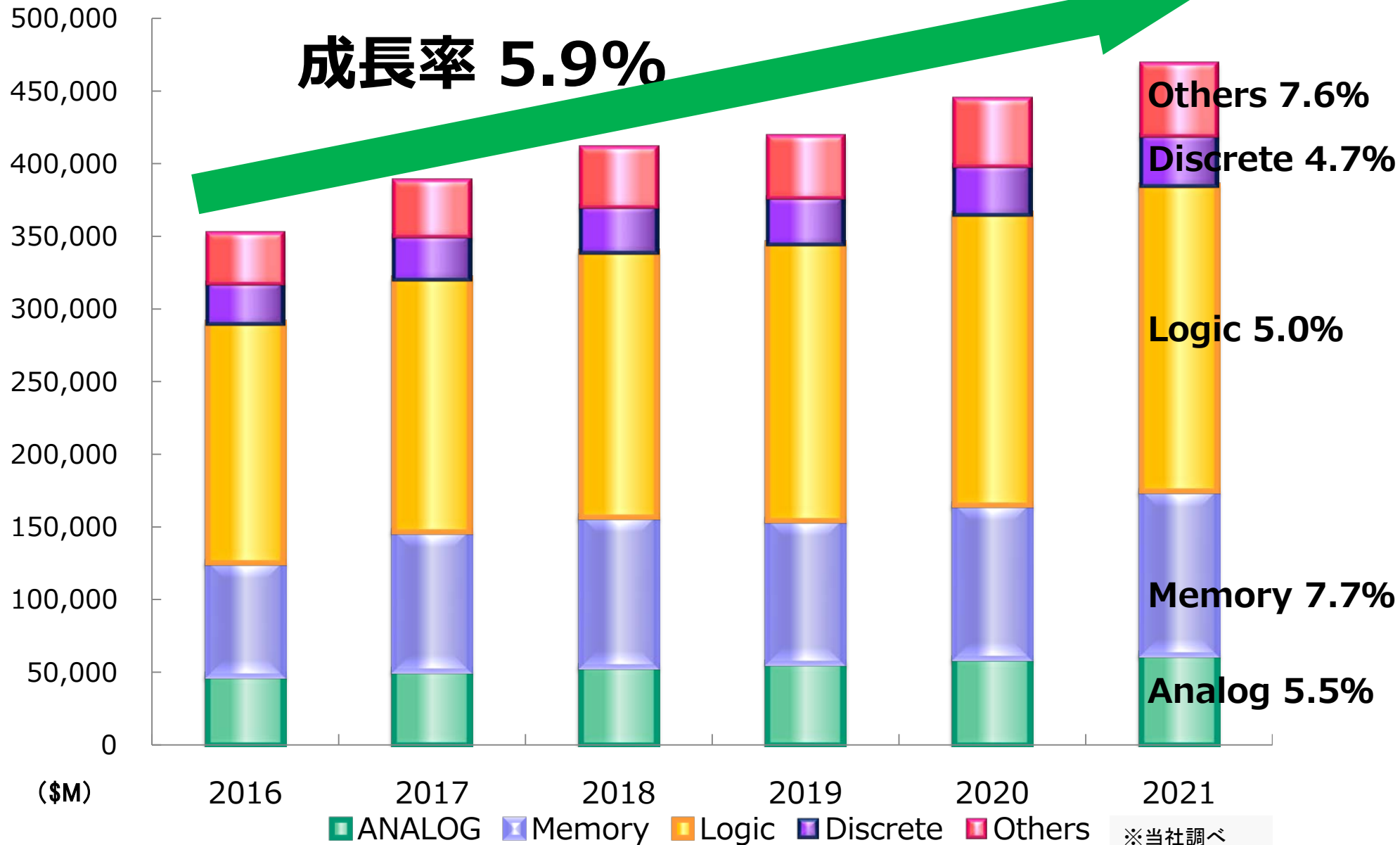
FY2020



売上高
300億円

営業利益
30億円

デバイス別半導体売上高予測



1. 既存事業の成長

- ・IoT時代を見据えた新機種開発
- ・生産改善活動

2. 新しいビジネス価値の開発

- ・Smart Bonding Solution の確立
- ・IoTを用いたサービスビジネスの拡大
- ・アライアンスの強化

3. 組織活性化と人材育成

- ・グローバル人材の強化
- ・ダイバーシティへの取り組み

E nvironment

- ・製品のライフサイクル
（中古事業、
リファービッシュ事業の拡大）
- ・製品の使用によるCO2排出量
削減（消費電力が少ない）
- ・生産におけるCO2排出量削減
- ・環境配慮型製品・サービスの
開発

S ociety

- ・顧客への対応（顧客サポート）
- ・安全衛生に関する取り組み
- ・ワーク・ライフ・バランス
- ・海外サプライヤーの
労働環境への取り組み
- ・地域社会への貢献活動
- ・ダイバーシティへの取り組み

G overnance

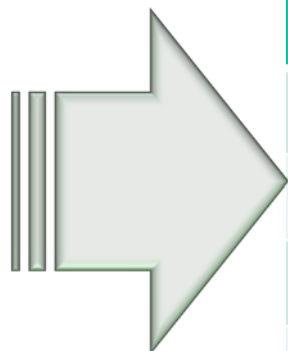
- ・コーポレートガバナンス、
内部統制
- ・グローバルマネジメントシステム
- ・役員報酬・インセンティブ
- ・取締役会の構成
- ・コンプライアンス徹底
- ・リスクマネジメント、
潜在的リスクの見える化活動
- ・事業継続計画（BCP）
- ・情報セキュリティ

Shinkawa Challenge Shinkawa 2020

業界トップグループへの返り咲きを目指します！

連結業績目標

(単位：百万円)	2017年3月期
売上高	16,438
営業利益	294
経常利益	432
当期純利益	243



2021年3月期	売上比 (%)	利益率改善幅
30,000	100.0	-
3,000	10.0	+8.2p
3,000	10.0	+7.4p
2,300	7.7	+6.2p

※最終年度ROEは、10%レベルを目指します。

ステークホルダー還元の方

永続的かつ安定的な利益還元

成長のための投資（設備投資、R & D、M & A）